

Title (en)
Contact field for connector

Title (de)
Kontaktfeld für Steckverbinder

Title (fr)
Champ de contact pour connecteur à fiches

Publication
EP 2375511 A1 20111012 (DE)

Application
EP 11161683 A 20110408

Priority
DE 102010014294 A 20100408

Abstract (en)
The contact field has an insulating material housing (5) and multiple metallic contacts (4) for a connection with a twisted-pair socket, where each metallic contact has a feed line section (6) for a connection with a printed circuit board. The metallic contacts are formed from contact plates, where two of the feed line sections are arranged offset relative to other feed line sections. The contact field is provided under specification of Category 6a.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Kontaktfeld für eine Steckverbindung für eine Twisted-Pair-Verkabelung. Das Kontaktfeld weist eine Mehrzahl von metallischen Kontakten zur Verbindung mit einer Twisted-Pair-Buchse auf, wobei jeder metallische Kontakt einen Zuleitungsabschnitt zur Verbindung mit einer Platine aufweist. Die metallischen Kontakte sind aus Kontaktblechen geformt, wobei wenigstens zwei der Zuleitungsabschnitte versetzt zu anderen Zuleitungsabschnitten angeordnet sind.

IPC 8 full level
H01R 24/64 (2011.01); **H01R 12/72** (2011.01); **H01R 13/6461** (2011.01); **H01R 13/6463** (2011.01)

CPC (source: EP US)
H01R 12/727 (2013.01 - EP US); **H01R 13/6463** (2013.01 - EP US); **H01R 24/64** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] WO 9701874 A1 19970116 - WHITAKER CORP [US]
- [A] US 5226835 A 19930713 - BAKER III FRANK P [US], et al
- [A] US 6290524 B1 20010918 - SIMMEL GEORGE M [US]
- [A] WO 9813899 A1 19980402 - PANDUIT CORP [US]
- [A] US 5772449 A 19980630 - FELDMEIER GUENTER [DE], et al

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2375511 A1 20111012; **EP 2375511 B1 20180815**; CN 102255159 A 20111123; CN 102255159 B 20150114;
DE 102010014294 A1 20111013; ES 2692620 T3 20181204; JP 2011222504 A 20111104; JP 5277280 B2 20130828;
US 2011256772 A1 20111020; US 8894446 B2 20141125

DOCDB simple family (application)
EP 11161683 A 20110408; CN 201110092095 A 20110407; DE 102010014294 A 20100408; ES 11161683 T 20110408;
JP 2011074629 A 20110330; US 201113081952 A 20110407